

公司代码：688019

公司简称：安集科技



**安集微电子科技（上海）股份有限公司**

**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的利润分配预案及公积金转增股本预案为：

公司拟以实施2022年度利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。截至2023年4月7日，公司总股本为75,974,210股，以此计算合计拟派发现金红利总额为31,909,168.20元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约10.32%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.59%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增3股，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。

### 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所科创板	安集科技	688019	不适用
----	------------	------	--------	-----

### 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨逊	冯倩
办公地址	上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5幢	上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5幢
电话	021-20693201	021-20693201
电子信箱	IR@anjimicro.com	IR@anjimicro.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。

在化学机械抛光液板块，公司致力于实现全品类产品线的布局和覆盖，旨在为客户提供完整的一站式解决方案。公司化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液等多个产品平台。同时，公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台，支持客户对于不同制程的需求，定制开发用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。

在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域，致力于攻克领先技术节点难关，并基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。目前，公司功能性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液等产品。

在电镀液及添加剂产品板块，公司完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，并在自有技术持续开发的基础上，通过技术引进等横向合作的形式，进一步拓展和强化了平台能力建设，提升了公司在相关领域的综合水平，且大幅度加速了规模量产的进程，研发产品已覆盖多种电镀液添加剂。

公司产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片，并已进入半导体行业领先客户的主流供应商行列。

同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，公司开始建立核心原材料自

主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。

## (二) 主要经营模式

### 1、采购模式

公司制定了《采购管理程序》和采购管理内部控制流程，并制定了《采购流程》、《供应商管理流程》、《供应灾难恢复程序》等标准作业程序。

#### (1) 一般采购流程

以原、辅材料和包装材料为例，公司的一般采购主要流程如下：

①技术研发部提出材料开发需求，采购部负责开发供应商，并由供应商管理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司合格供应商，采购部负责建立并维护《合格供应商目录》。公司供应商管理小组由采购部、技术研发部、质量部、生产运营部等部门人员组成。

②需求部门提出采购申请，并按照公司审批政策得到合适的批准后提交采购部，采购部负责管理订单执行，质量部负责采购来料检验管理，仓库负责采购入库管理。

③采购部按照采购合同/订单，获取发票，并整理入库及验收等付款凭证提交财务部申请付款并得到审批。

④财务部按照采购合同/订单约定负责采购应付款管理。

#### (2) 外协采购流程

报告期内，公司功能性湿电子化学品中的部分光刻胶剥离液存在委托外协供应商生产的情形，即公司与外协供应商签订协议，外协供应商严格按照公司提供的工艺文件、技术标准来组织生产，进行质量管理控制。公司所有的产品配方、生产工艺、任何发明、设计、技术信息、技术、专有技术或者由公司依协议授权外协供应商使用的商标、商业秘密及其他知识产权属于公司单独所有。公司的外协采购主要流程如下：

①生产运营部根据月度销售预测生成外协采购申请单；

②采购部根据外协采购申请单下订单；

③外协供应商按订单要求安排生产；

④财务部每月末进行外协采购成本核算。

### 2、研发模式

公司始终围绕自身的核心技术，以自主研发、自主创新为主，形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时，公司与高校、客户等外部单位建立了良好的合作关系，积极开展多层次、多方式的合作研发。公司的研发目标一方面系跟随行业界的技术发展路线图，研发适应产业

需求的产品平台；另一方面系基于下游客户的需求，针对性研发满足客户需求的产品。由于从开始研发到实现规模化销售需要较长的时间，公司与技术领先的客户合作开发，有助于了解客户需求并为其开发创新性的解决方案。

公司制定了《研发管理制度》，并建立了研发管理内部控制流程，涵盖研发计划、研发立项、研发过程跟进和费用核算管理、专利申请和取得等环节。公司产品研发及产业化的一般路径主要包括项目立项、产品开发、产品优化和定型、量产、持续改进等五个阶段。

### 3、生产模式

公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流。当产品通过客户评价和测试后，销售部会根据客户的产品订单及对于客户使用需求的预测制定滚动出货预测，生产运营部根据年度/月度生产计划、滚动出货预测和库存情况制订具体的生产计划、安排库存。具体而言，生产运营部每年组织各相关部门，根据排产计划编制年度生产计划及月度生产计划。生产运营部会定期进行集体评审，根据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的每周生产计划，以确保生产计划满足销售合同以及生产产能的要求；生产运营部组织各相关部门、各产品线负责人召开生产调度会，对生产计划的执行情况进行评审，以确保充分沟通可能影响生产计划变更的各种因素，及时调整生产计划（如及时关闭停工订单），以确保计划调整的及时性及其有效性。

公司已经掌握了化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂生产中的核心技术，通过合理调配机器设备和生产资源组织生产。

### 4、销售模式

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，销售主要采用直接面对终端客户的直销模式。公司在开拓新客户或在原有客户推广新产品时，首先要根据客户的需求进行认证测试，包括产品性能、可靠性、稳定性等多方面测试，认证测试周期一般较长。公司在通过下游客户认证后，客户直接向公司下达采购订单，公司按要求直接向客户发货。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### 1. 公司所处行业

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为

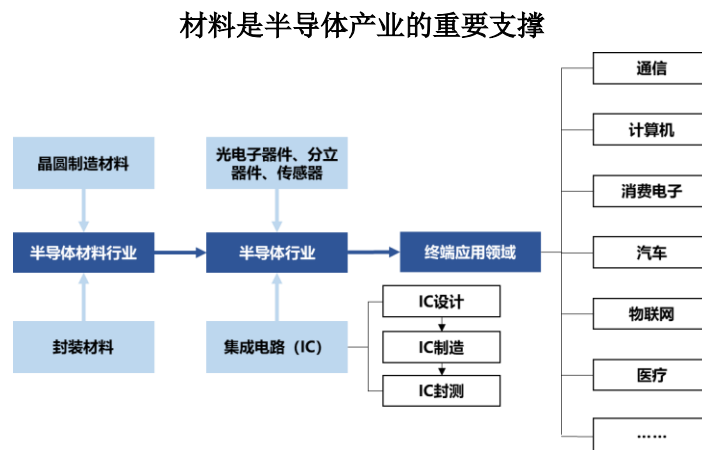
“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准，公司所处行业为半导体材料行业。

公司产品作为新一代信息技术产业用材料，属于战略性新兴产业中新一代信息技术产业和新材料产业的交叉领域。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“1 新一代信息技术产业——1.2 电子核心产业——1.2.3 高储能和关键电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）”和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造（C3985 电子专用材料制造）”。

## 2. 行业基本特点及主要技术门槛

材料和设备是半导体产业的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖一代材料和设备来实现。

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。



第一，产业规模大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。根据 SEMI，2021 年全球半导体材料销售额为 643 亿美元，相较于 2020 年的 555 亿美元同比增长 15.9%，其中晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为 404 亿美元和 239 亿美元，同比增长率分别为 15.5%和 16.5%。从地区来看，2021 年中国台湾凭借其强大的晶圆代工和先进封装基础，以 147 亿美元连续第十二年成为半导体材料的最大消费地区，增长率 15.7%；中国大陆由于积极建厂，半导体材料市场销售额 119 亿美元，增长率 21.9%，继续超越韩国位列第二。

第二，细分行业多。半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业链环节，其中晶圆制造材料包括硅片、光掩模、光刻胶、光刻胶辅助材料、工艺化学品、电子特气、抛光液和抛光垫、靶材及其他材料，封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、包封材料、芯

片粘结材料及其他封装材料，每一种大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品，细分子行业多达上百个。

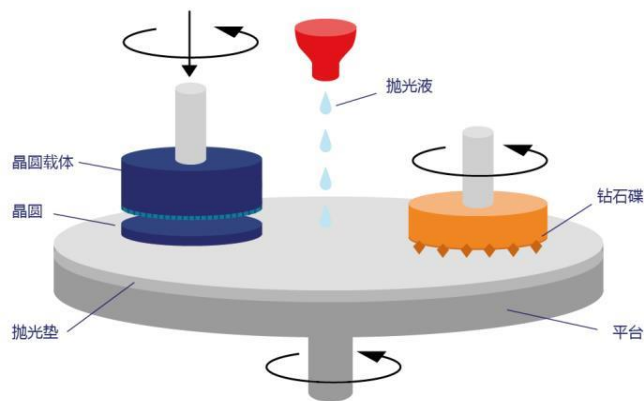
第三，技术门槛高、研发投入大、研发周期长。由于半导体材料尤其是晶圆制造材料在集成电路芯片制造中扮演着重要的角色，甚至部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向，因此下游客户对于产品的要求极为苛刻，在上线使用前需要长周期的测试论证工作，并且上线使用后也会通过较长周期逐步上量。加之产品在能够进入测试论证阶段之前需要经历长时间、高难度的研发阶段，研发过程中需要大量的研发投入。

### 3. 行业发展阶段及化学机械抛光液、湿电子化学品、电镀液及添加剂细分领域市场情况

#### A. 化学机械抛光液市场情况

化学机械抛光（CMP）是半导体先进制程中的关键技术，其主要工作原理是在一定压力下及抛光液的存在下，被抛光的晶圆对抛光垫做相对运动，借助纳米磨料的机械研磨作用与各类化学试剂的化学作用之间的高度有机结合，使被抛光的晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求。根据不同工艺制程和技术节点的要求，每一片晶圆在生产过程中都会经历几道甚至几十道的 CMP 抛光工艺步骤。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 工艺是通过表面化学作用和机械研磨的技术结合来实现晶圆表面微米/纳米级不同材料的去除，从而达到晶圆表面的高度（纳米级）平坦化效应，使下一步的光刻工艺得以进行。

CMP 工艺原理图



随着制程节点的进步，CMP 技术越来越重要，已成为  $0.35\ \mu\text{m}$  以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。此外，先进封装技术的应用使 CMP 从集成电路前道制造环节走向后道封装环节，如硅通孔（TSV）等先进封装技术对

引线尺寸要求更小更细，因此会引入刻蚀、光刻等工艺，而 CMP 作为每道工艺间的抛光工序，得以广泛应用。

对于逻辑芯片，制程的缩小意味着光刻次数、刻蚀次数增加，也带动 CMP 工艺步骤数增加。例如 14 纳米技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺步骤数将由 180 纳米技术节点的 10 次增加到 20 次以上，而 7 纳米及以下技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺步骤数甚至超过 30 次。此外，更先进的逻辑芯片工艺可能会要求抛光新的材料，为抛光液带来了更多的增长机会。同样地，对于存储芯片，随着由 2D NAND 向 3D NAND 演进的技术变革，也会使 CMP 工艺步骤数近乎翻倍，带动了钨抛光液及其他抛光液需求的持续快速增长。

化学机械抛光液在 CMP 技术中至关重要，其耗用量随着晶圆产量和 CMP 平坦化工艺步骤数增加而增加。根据应用的不同工艺环节，可以将抛光液分为硅抛光液、铜及铜阻挡层抛光液、钨抛光液、介质层抛光液、浅槽隔离（STI）抛光液以及用于先进封装的硅通孔（TSV）抛光液等。抛光液特点为种类繁多，即使是同一技术节点根据不同客户的工艺技术要求也有不同配方，其主要原料包括纳米磨料、各种添加剂和超纯水。其中，纳米磨料是决定抛光液性能的关键原料，主要包括硅溶胶、气相二氧化硅和二氧化铈等品类。

根据 TECHCET，2022 年全球晶圆制造用抛光液市场规模预计超过 20 亿美元，2026 年将达到 26 亿美元。根据中金公司证券研究报告，国内抛光液市场增速有望显著高于全球市场，2025 年国内抛光液市场有望占全球市场的 25%，达 40 亿元，2021-2025 年复合增长率达 15%。

## B. 湿电子化学品市场情况

湿电子化学品是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组成成分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品和功能性湿化学品两大类。通用湿化学品以高纯溶剂为主，例如过氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等。功能性湿化学品是指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括光刻胶剥离液、清洗液、刻蚀液等。

具体而言，功能性湿电子化学品在半导体制造领域的应用主要涉及光刻、刻蚀、离子注入、CMP 工艺。光刻工艺结束后，下一步工艺为刻蚀工艺，首先用到的湿化学品为刻蚀液，通过特定的溶液与需要刻蚀的薄膜材料发生化学反应，除去光刻胶未覆盖区域的薄膜，被称为湿法刻蚀。刻蚀后，需要对未曝光部分的光刻胶进行去除，此时用到的湿化学品为光刻胶剥离液，剥离液要求对光刻胶有较强的溶解性能。在金属化工艺中，应用的主要湿化学品为铜电镀液，起到芯片铜



互连的作用，铜互连工艺具有更低的电阻率、抗电迁移性，能够满足芯片尺寸越小、功能越强大、能耗更低的技术性能要求。清洗液用于半导体制造的清洗工艺，去除灰尘、微粒、金属或离子型导电污染物及有腐蚀作用的无机、有机污染物等。根据其应用工艺不同，清洗液可分为化学机械抛光（CMP）后清洗液、铝工艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液等。

湿电子化学品的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响。随着集成电路技术的不断发展，湿电子化学品必须与之同步发展。以逻辑芯片制造工艺为例，根据 CMC Materials 官网公开披露的资料，5 纳米技术节点所要求的总工艺步骤数将由 28 纳米技术节点的 400 次左右增加到 1,200 次以上，其中清洗工艺步骤数占总工艺步骤数的 25~30%，进一步带动了高端湿电子化学品的需求。此外，随着技术节点的进步，下游客户对纯度及污染物控制的要求也会提高，以避免可能引致的产品缺陷。

根据中国电子材料行业协会统计，2022 年全球集成电路用湿化学品市场规模预计为 56.90 亿美元，2025 年将进一步增加到 63.81 亿美元；中国集成电路用湿化学品总体市场规模预计 2025 年将增长至 10.27 亿美元。

### C. 电镀液及添加剂市场情况

铜互连技术是集成电路制造的关键工艺。在铜互连电镀工艺中，将带有扩散阻挡层和籽晶层的芯片浸没在含有添加剂的高纯电镀液中，用电镀工艺填充已经刻蚀好的互连穿孔（Via）和槽隙（Trench）。其中铜互连电镀添加剂包括加速剂、抑制剂及整平剂，在电镀工艺中起到关键作用，通过不同组分相互作用，实现从下到上填充效果以及镀层晶粒、外观及平整度。大马士革铜互连工艺在 8 英寸以上晶圆、130nm 以下芯片制造中得到广泛应用。

在先进封装方面，为了进一步提高集成电路性能，需要缩短晶圆间、晶圆与印刷电路板间连线距离，超越摩尔技术变得越来越重要。电镀是超越摩尔技术关键工艺，具体包括凸块电镀（Pillar bump、solder bump、gold bump）、再分布线（RDL）、硅通孔（TSV）电镀等。

随着先进逻辑器件技术节点带来的互连层的增加，先进封装对重新布线层和铜柱结构应用的增加，以及广泛运用铜互连技术的半导体器件整体增长，带动了电镀液及其添加剂市场的增长。根据 TECHCET 预测，2022 年全球集成电路电镀液市场规模将增长 8.1%，达到 10.19 亿美元。其中铜互连电镀液是集成电路电镀液市场最大的组成部分，预计 2022 年将超过 7.10 亿美元，2021-2026 年复合增长率为 8.6%。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来一直致力于集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等产品的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。报告期内，公司进一步拓展产品及技术平台，成功搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其添加剂产品系列平台。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，并在部分制程开启行业原始创新，使中国在该领域拥有了自主供应能力。公司经过多年以来的技术和经验积累、品牌建设，凭借扎实的研发实力及成本、管理和服务等方面的优势，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在化学机械抛光液板块，积极加强、全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案；在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难并提供相应的产品和解决方案；在电镀液及添加剂板块，成功搭建应用于集成电路制造及先进封装领域的技术平台，实现电镀高端产品系列国产突破。公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2022年，国际贸易摩擦对半导体产业的影响仍在持续，外部环境的波动也给整个行业的发展带来了诸多不确定性。但是可以确定的是，众多的应用如人工智能、AR / VR、物联网、自动驾驶汽车、云计算、5G / 6G、智能城市、医疗健康等都依赖于半导体技术进步来实现其创新。半导体行业的发展源动力深远而巨大，发展驱动力依旧强劲，多个国家和地区出台的提振本土半导体产业发展的相关政策和各界资金向半导体行业的集中反映出相关政府和市场对于行业的认可和正向预期。

2021年是“十四五”规划的开局之年，全国各地都制定了集成电路相关产业规划，并提出了2025年产业规模目标。预估到2025年，我国集成电路产业规模将高达4万亿元。国家及地方集成电路产业基金也继续向集成电路产业投资支持产业发展。此外，汽车行业、手机厂商和互联网企业也向芯片制造领域延伸。国内芯片制造及先进封装市场规模的增长也带动了对上游关键材料需求的增长，为公司未来业务增长提供了有力支撑。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	2,047,601,294.07	1,672,228,439.94	22.45	1,287,346,347.95
归属于上市公司股东的净资产	1,521,549,944.38	1,201,160,935.33	26.67	1,048,104,787.37
营业收入	1,076,787,316.10	686,660,621.16	56.82	422,379,914.28
归属于上市公司股东的净利润	301,436,958.70	125,084,063.28	140.99	153,989,118.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,453,800.14	91,107,538.21	229.78	58,850,726.56
经营活动产生的现金流量净额	239,122,116.48	61,105,784.69	291.32	113,173,725.28
加权平均净资产收益率(%)	22.20	11.11	增加11.09个百分点	15.94
基本每股收益(元/股)	4.59	2.35	95.32	2.90
稀释每股收益(元/股)	4.58	2.35	94.89	2.90
研发投入占营业收入的比例(%)	14.99	22.30	减少7.31个百分点	21.05

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	233,076,596.48	270,289,061.40	290,405,517.16	283,016,141.06
归属于上市公司股东的净利润	39,600,955.23	87,259,722.87	79,696,576.31	94,879,704.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,644,245.73	84,896,681.35	90,324,404.39	74,588,468.67
经营活动产生的现金流量净额	31,839,635.11	30,026,314.28	73,905,098.56	103,351,068.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)									8,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)									7,953
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）									0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）									0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）									0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）									0
前十名股东持股情况									
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质	
						股份 状态	数量		
Anji Microelectronics Co., Ltd.	5,584,131	28,144,459	37.68	0	0	无	28,144,459	其他	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	488,082	5,438,545	7.28	0	0	无	5,438,545	国有法人	
全国社保基金四零六组合	0	1,817,304	2.43	0	0	无	1,817,304	其他	
上海大辰科技投资有限公司	0	1,700,039	2.28	0	0	无	1,700,039	境内非国有法人	
香港中央结算有限公司	192,750	1,435,394	1.92	0	0	无	1,435,394	其他	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	0	800,000	1.07	0	0	无	800,000	其他	

上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	0	709,871	0.95	0	0	无	709,871	其他
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	199,957	700,000	0.94	0	0	无	700,000	其他
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞 6 号瑞行基金	320,727	675,272	0.90	0	0	无	675,272	其他
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	-420,824	598,565	0.80	0	0	无	598,565	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

#### 存托凭证持有人情况

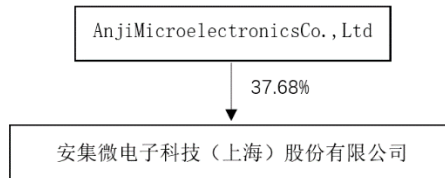
适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 107,678.73 万元，同比增长 56.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 30,143.70 万元，同比增长 140.99%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 30,045.38 万元，同比增长 229.78%。报告期末，公司总资产 204,760.13 万元，较报告期期初增长 22.45%；归属于母公司的所有者权益 152,154.99 万元，较报告期期初增长 26.67%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

法定代表人：Shumin Wang

日期：2023 年 4 月 10 日